

OS-C II

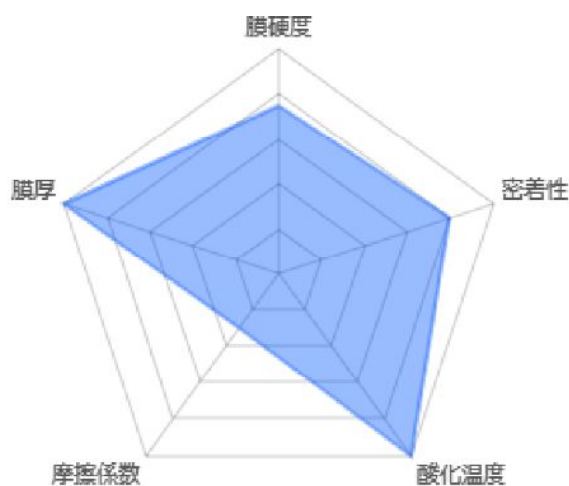


OS-Cを成膜条件の最適化でバージョンUP
耐チッピング性、耐摩耗性を改良しました。

用途：ドライ加工用工具（低硬度材）
 HRC40以下の被削材のドライ切削
 耐熱用金型

— スペック

色調	膜硬度	膜厚	酸化温度
シルバー	2300~2500Hv	3~5μm	1000°C
処理温度	摩擦係数	膜種	
450~500°C	0.4	CrSi系	



— 特長

1、耐チップング性向上

試験 1

■目的

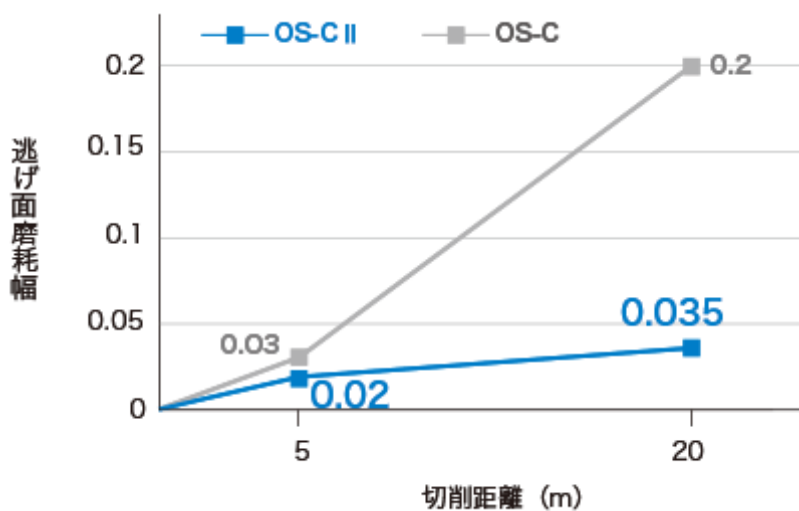
SCM440 (285HB) WET切削試験
切削距離20mでの逃げ面摩耗比較

■試験内容

超硬4刃エンドミル $\phi 4$
切削速度：46m/min (3700min⁻¹)
送り：0.04mm/tooth
vf：592mm/min
ap × ae = 6*0.1mm

■結果

逃げ面摩耗幅が18%減



2、低速切削に強い

試験2

■目的

S N C M加工 WET切削試験
切削距離

■試験内容

SKH 4刃エンドミル $\phi 20$
切削速度：10m/min (150min⁻¹)
送り：38mm/tooth
vf：24mm/min

■結果

切削距離が1.75倍

